

Добро пожаловать в O-Leading

O-Leading стремится быть вашим универсальным партнером по решениям в цепочке поставок EMS, включая проектирование печатных плат, изготовление печатных плат и сборку печатных плат ([Производитель модуля питания многослойной платы Китай](#)), Мы предоставляем одни из самых передовых технологий печатных плат, включая печатные платы HDI, многослойные печатные платы, жесткие и гибкие печатные платы. Мы можем поддерживать от прототипа быстрого поворота до среднего и массового производства.

В целом, наши глобальные клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрое реагирование, конкурентоспособные цены и приверженность качеству. Предоставление более ценных технических услуг и комплексных решений - это путь, ведущий вперед.

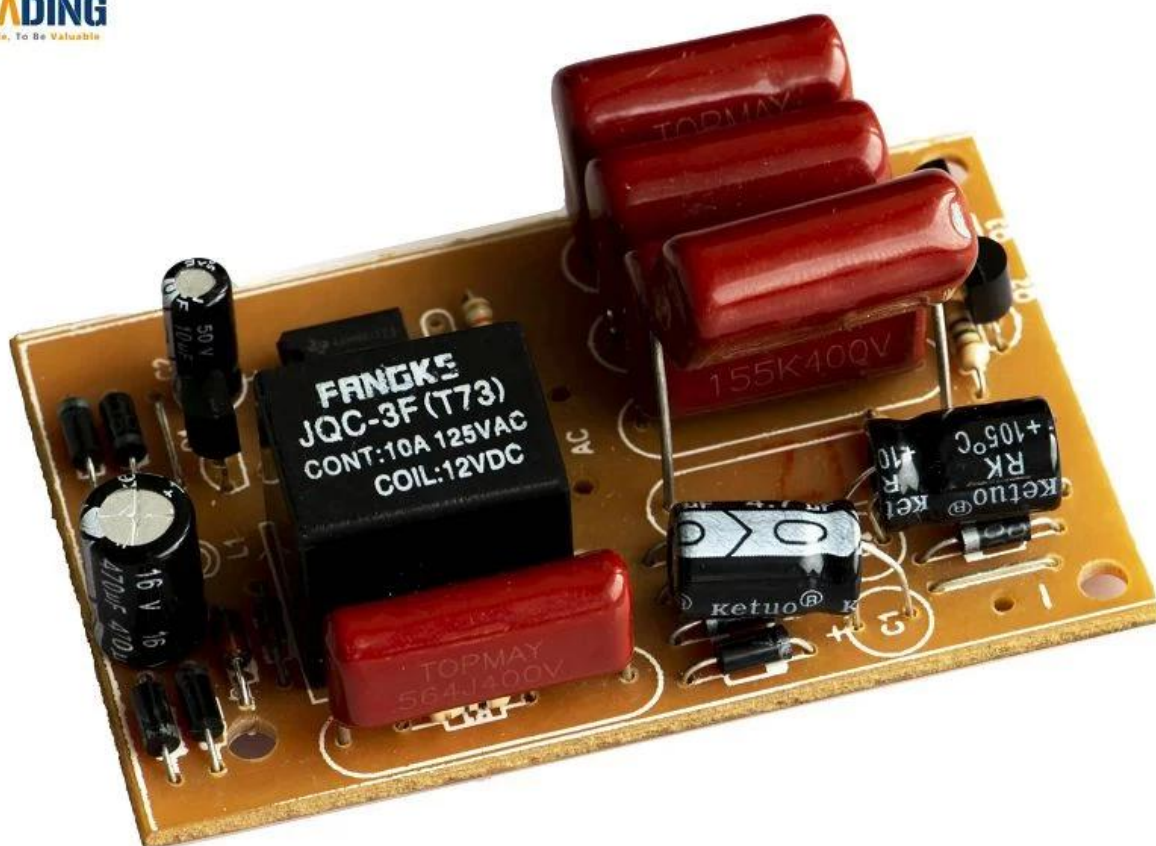
Заглядывая в будущее, O-Leading, как всегда, сосредоточится на инновациях и развитии технологий производства электроники и будет прилагать настойчивые усилия к универсальному обслуживанию печатных плат и печатных плат, чтобы предоставлять первоклассные услуги и создавать большую ценность для наших клиентов.

ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЭТИ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ [Модуль печатной платы светодиодной лампы SMD 12 Вт](#)



Описание товара

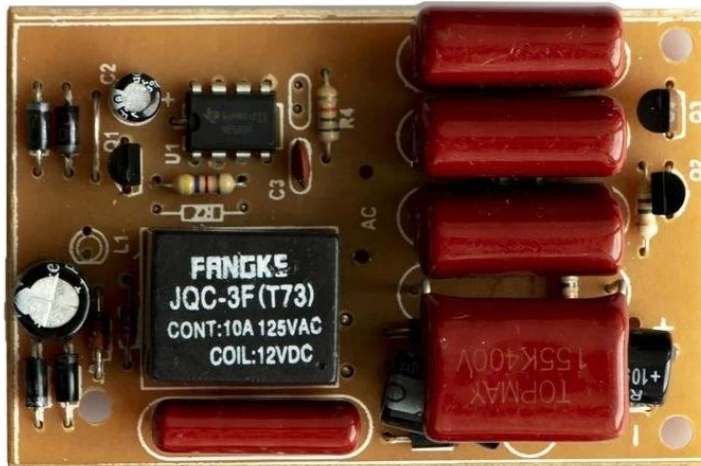
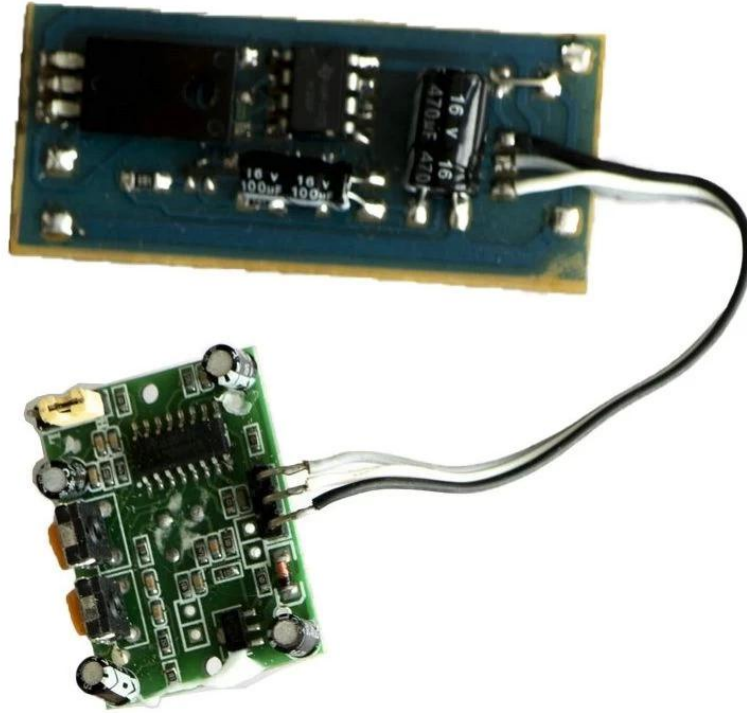
O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



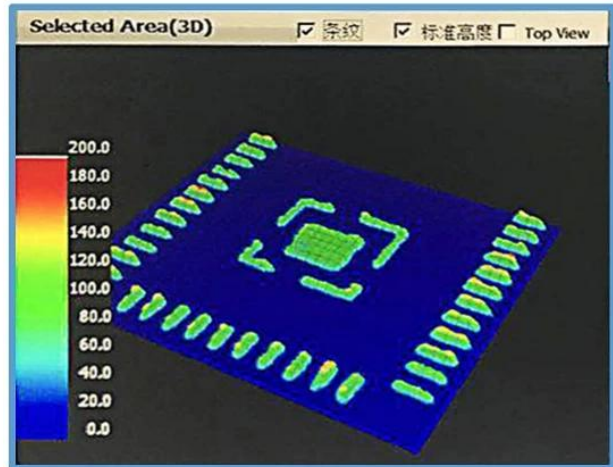
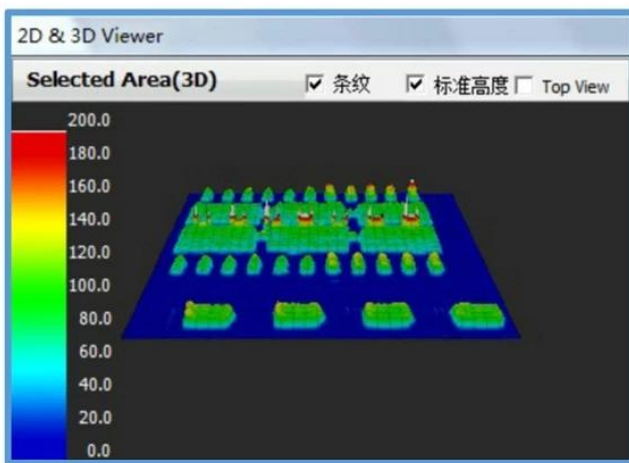
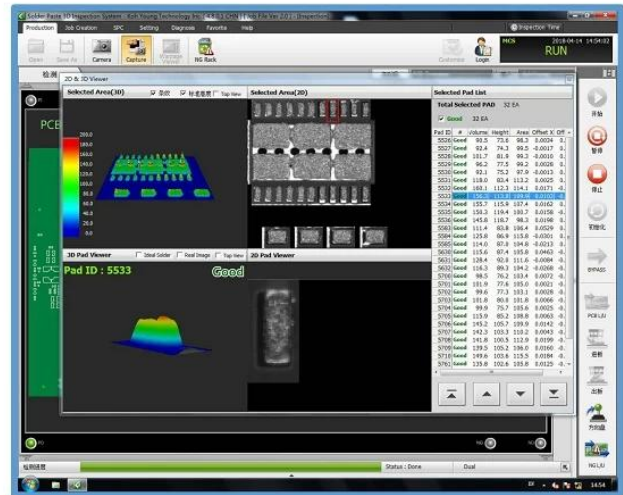
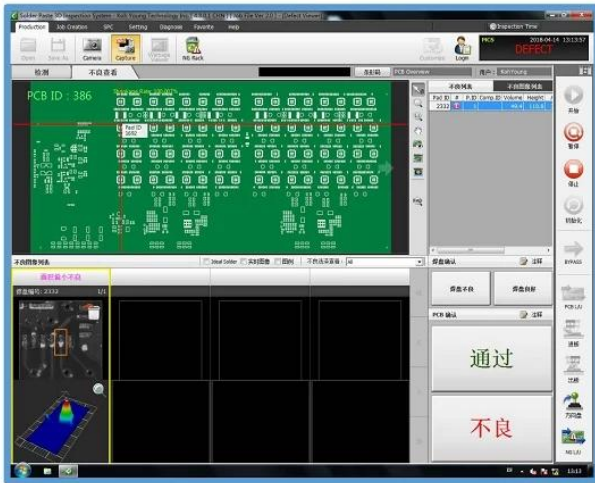
O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



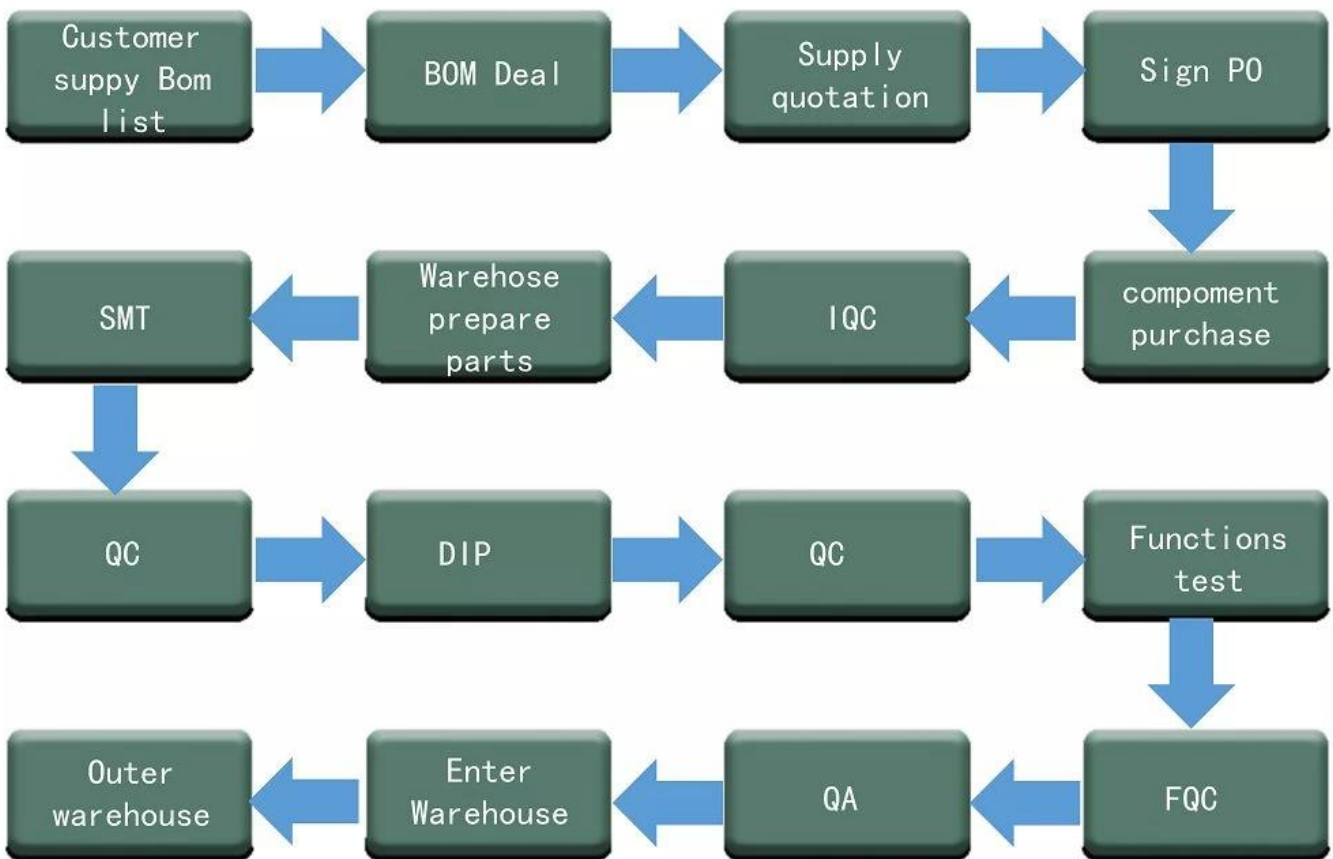




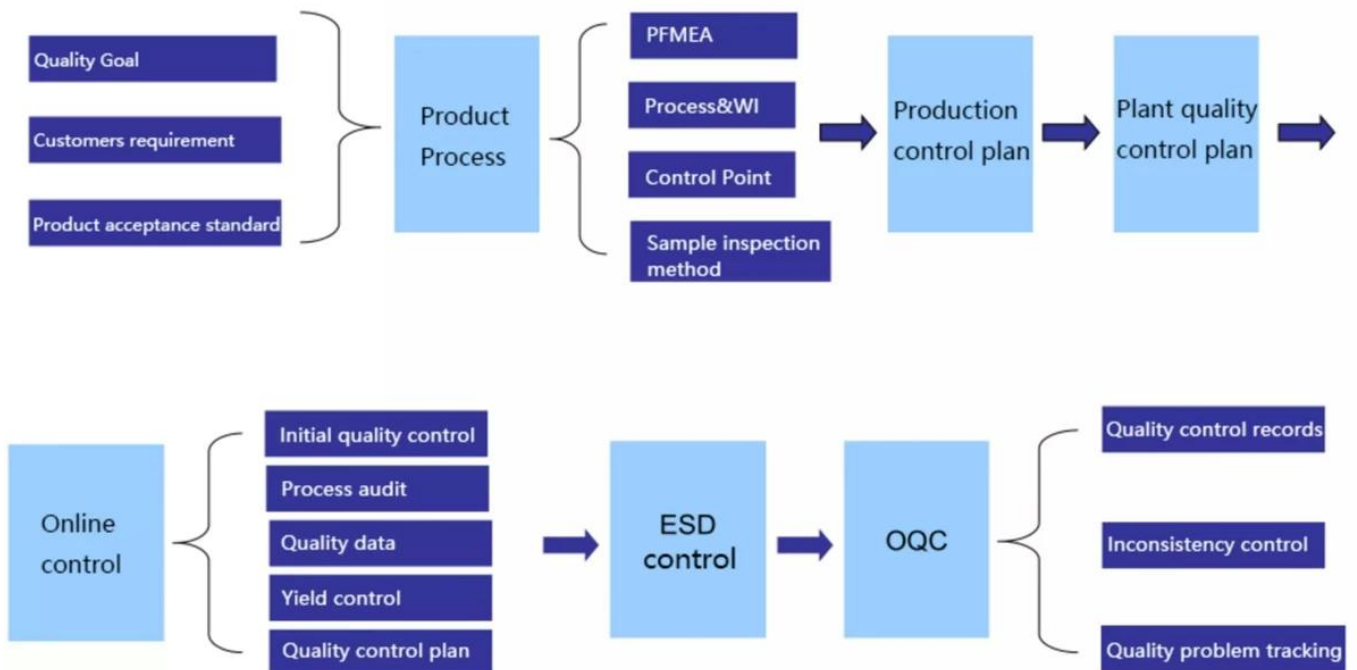
KOHYOUNG solder pasteig check SPI Figure 3 d imaging



Process Flow Chart



Quality Control Process



Market Share

CONSUMER ELECTRONICS

AUTOMOTIVE ELECTRONICS

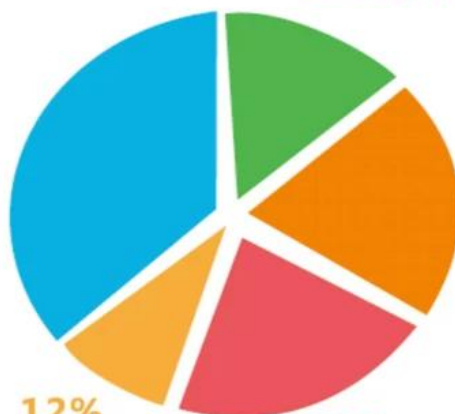
INDUSTRIAL CONTROL

INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

OTHER



30%
CONSUMER ELECTRONICS



18%
INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

20%
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



12%
OTHER



20%
INDUSTRIAL CONTROL



Наша команда

Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Сертификаты





ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width			SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets UL796	C T	
	Min	Cond	Area		Solder	Oper	Flame			
	mm(in)	Edge mm(in)	Thk mic(mil)		Diam mm(in)	Limits C sec				Temp C
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.										
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All
Multilayer printed wiring boards.										
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All *
Single layer printed wiring boards.										
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All -
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲ -
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All -
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All -
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All -
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All *
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All *

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲ *
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All *

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Возможности процесса

Возможности производства печатных плат

Количество слоев	1Слой-32Слой
Толщина готовой меди	1/3 - 12 унций
Мин. Ширина линии / внутренний интервал	3,0 мил / 3,0 мил
Мин. Ширина линии / внешний интервал	4,0 мил / 4,0 мил
Максимальное соотношение сторон	10: 1
Толщина доски	0,2 мм-5,0 мм
Максимальный размер панели (дюймы)	635 * 1500 мм
Минимальный размер просверленного отверстия	4мил
Допуск отверстий с отверстиями	+/- 3мил
Blind / Buried Vias (типы AII)	ДА
Через заливку (проводящий, непроводящий)	ДА
Базовый материал	FR-4, FR-4high Tg. Материал без галогенов, Rogers, алюминиевая основа,Полиимид, тяжелая медь
Отделка поверхности	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,олово lmmersion, золотые пальцы, угольные чернила

Возможности производства SMT

Материал печатной платы	FR-4, СЕМ-1, СЕМ-3, плита на основе алюминия
Максимальный размер печатной платы	510x460 мм
Минимальный размер печатной платы	50x50 мм
Толщина печатной платы	0,5 мм-4,5 мм
Толщина доски	0,5-4 мм
Мин. Размер компонентов	0201
Компонент стандартного размера чипа	0603 и больше
Макс.высота компонента	15мм
Мин. Шаг	0,3 мм
Мин. Шаг мяча BGA	0,4 мм
Точность размещения	+/- 0,03 мм

Упаковка и доставка

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Часто задаваемые вопросы

1. Как O-Leading обеспечивает качество?

Наш высокий стандарт качества достигается следующим образом.

1.1 Процесс строго контролируется стандартами ISO 9001: 2008.

1.2 Широкое использование программного обеспечения для управления производственным процессом

1.3 Современное испытательное оборудование и инструменты. Например. Летящий зонд, рентгеновский контроль, AOI (автоматический оптический инспектор) и ICT (внутрисхемное тестирование).

1.4 Выделенная группа обеспечения качества с процессом анализа случаев отказа

1.5. Непрерывное обучение и обучение персонала

2. Как O-Leading поддерживает конкурентоспособность ваших цен?

За последнее десятилетие цены на многие виды сырья (например, медь, химикаты) выросли в два, три или четыре раза; Китайская валюта юань выросла на 31% по сравнению с долларом США; И стоимость нашей рабочей силы также значительно выросла.

Однако O-Leading сохранила наши цены на стабильном уровне. Это полностью связано с нашими инновациями в снижении затрат, предотвращении потерь и повышении эффективности. Наши цены очень конкурентоспособны в отрасли при том же уровне качества.

Мы верим в беспроигрышное партнерство с нашими клиентами. Наше партнерство будет взаимовыгодным, если мы сможем предоставить вам крайнюю стоимость и качество.

3. Какие виды досок могут обрабатывать O-Leading?

Обычные платы FR4, с высоким TG и без галогенов, Rogers, Arlon, Telfon, платы на основе алюминия / меди, PI и т. Д.

4. Какие данные необходимы для производства печатных плат и печатных плат?

4.1 BOM (Bill of Materials) с позиционными обозначениями: описание компонента, название производителя и номер детали.

4.2 Файлы PCB Gerber.

4.3 Производственный чертеж печатной платы и сборочный чертеж печатной платы.

4.4 Процедуры испытаний.

4.5 Любые механические ограничения, например требования к высоте сборки.

5. Каков типичный технологический процесс для многослойной печатной платы?

Резка материала → Внутренняя сухая пленка → внутреннее травление → Внутренний AOI → Многослойная связка → Слой наложения Нажатие → Сверление →PTH → Покрытие панели → Внешняя сухая пленка → Узорное покрытие → Внешнее травление → Внешний AOI → Маска припоя → Метка компонента → Обработка поверхности → Маршрут → E / T → Визуальный осмотр.

6. Какое основное оборудование для производства HDI?

Список основного оборудования следующий: лазерный сверлильный станок, прессовочный станок, линия VCP, автоматический экспонирующий станок, LDI и т. Д.

Наше оборудование является лучшим в отрасли, лазерные сверлильные станки производства Mitsubishi и Hitachi, станки LDI производства Screen (Япония), автоматические экспонирующие машины также производства Hitachi, все они позволяют удовлетворить технические требования клиентов.

7. Сколько типов финишной обработки поверхности можно сделать с помощью грифеля?

O-the Leader имеет полный спектр отделки поверхности, такой как: ENIG, OSP, LF-HASL, золотое покрытие (мягкое / твердое), иммерсионное серебро, олово, серебряное покрытие, иммерсионное лужение, угольные чернила и т. Д. OSP, ENIG, OSP + ENIG, обычно используемые на HDI, мы обычно рекомендуем использовать клиент или OSP OSP + ENIG, если размер BGA PAD менее 0,3 мм.

8. Каковы ваши возможности для FPC? Может ли O-Leading также предоставлять услуги SMT?

O-Leading может изготавливать FPC от одного до восьми слоев, размер рабочей панели может достигать 2000 мм * 240 мм, подробности см. На странице «Возможности Flex».

Мы также предоставляем клиентам комплексное обслуживание SMT.

9. Какие основные факторы повлияют на цену печатной платы?

Материал;

Чистота поверхности;

Технологическая сложность;

Различные критерии качества;

Характеристики печатной платы;

Условия оплаты;

Разные страны-производители.

10. Каково определение понятий PCB, PWB и FPC и в чем разница?

PCB - сокращение от Printed Circuit Board;

PWB - сокращение от Printed Wire Board, то же самое, что и Printed Circuit Board;
FPC - это сокращение от гибкой печатной платы.

11. Какие факторы следует учитывать при выборе материала для печатной платы?

При выборе материала для печатной платы следует учитывать следующие факторы:

Значение Tg материала должно быть выше рабочей температуры;

Материал с низким CTE обладает хорошими показателями термической стабильности;

Хорошие характеристики термического сопротивления: Обычно требуется, чтобы печатные платы выдерживали 250 °C не менее 50 секунд.

Хорошая ровность; Принимая во внимание электрические свойства, на высокочастотной печатной плате используется материал с низкими потерями / высокой диэлектрической проницаемостью;

Подложка из полиимидного стекловолокна, используемая для гибких печатных плат;

Металлический сердечник используется, когда к продукту предъявляются строгие требования по отводу тепла.

12. В чем заключаются достоинства жесткой гибкой печатной платы O-Leading?

Жестко-гибкая печатная плата O-Leading имеет характеристики как FPC, так и печатной платы, поэтому ее можно использовать в некоторых специальных продуктах. Одна часть является гибкой, а другая - жесткой, это может помочь сэкономить внутреннее пространство продукта, уменьшить объем продукта и повысить производительность.

13. Как произвести расчет импеданса?

Система контроля импеданса выполняется с использованием некоторых тестовых образцов, SI6000 soft и оборудования CITS 500s от POLAR INSTRUMENTS.

Оборудование измеряет импеданс на типичном купоне конфигурации дорожки, для которого клиент предоставил нам определенное значение и допуск.